산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 1. 16.(화) 13:00 < 1.17.(수) 조간 > 배포 2024. 1. 16.(화)

장관, 반도체 설계 전문기업 방문

- 연이은 반도체 행보로 국가 반도체 역량 총결집
- 「팹리스 경쟁력 강화방안」 금년 상반기 중 마련

산업통상자원부 안덕근 장관은 1.16.(화) 판교에 위치한 반도체 설계 전문기업(이하 팹리스)인 텔레칩스를 방문했다. 안 장관은 1.11.(목) SK하이닉스 이천 사업장 방문 이후 연이은 반도체 행보를 이어가고 있다. 안 장관의 반도체 행보는 "반도체가 곧 민생이다"는 인식 아래, 글로벌 반도체 전쟁에서의 승리를 위해 대기업 중심의 메모리·파운드리부터 중소·중견기업 중심의 팹리스까지 우리 기업 역량을 총 결집하기 위함이다.

이날 텔레칩스와의 간담회에서 안 장관은 어제 정부가 발표한 「반도체 메가클러스터 조성방안」을 차질없이 이행해나가는 한편, 특히 파운드리와 함께 시스템반도체의 양대 축인 팹리스의 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다.

정부는 팹리스 성장(스케일업)을 촉진하기 위해 금융지원을 확대한다. 먼저, 지난해 결성된 3천억원 규모의 '반도체 생태계 펀드'를 본격 집행한다. 총 6년간('24~'29년)의 투자기간 중 올해 안에 총 투자규모의 약 1/4에 해당하는 700억원을 조기 투입할 계획이다. 또한, 시중금리 대비 1.3%p 우대금리를 제공하는 대출·보증 프로그램도 올해부터 3년간 24조원 규모로 지원한다. 이는 연평균 8조원 규모로 지난해 6.6조원 지원 규모 대비 20% 이상 확대된 것이다.

팹리스의 신기술·신제품 개발 지원도 강화한다. 개발된 칩의 성능 검증을 지원하는 공공 인프라를 신규 구축하고, 정부의 반도체 시제품 제작 지원 대상 범위를 기존 10나노 이상 공정뿐만 아니라 제작 단가가 높은 10나노 이하 공정까지 확대하는 등 팹리스의 첨단칩 개발을 지원한다. 또한, 팹리스가 시제품 제작을 위해 이용하는 국내 파운드리 공정 개방 횟수도 지난해 62회 대비 16% 늘어난 72회로 확대하여 접근성을 높인다.

팹리스의 외연 확장도 지원한다. 팹리스가 전방산업의 수요를 빠르고 정확하게 파악할 수 있도록 팹리스와 수요기업이 소통하는 기술교류회를 금년 1월 신설한다.

이날 텔레칩스 이장규 대표는 정부의 반도체 정책이 마련된 것에 환영의 뜻을 밝히면서, "반도체 기업이 과감히 투자하고 세계시장에 도전할 수 있도록 인센티브를 확대하고 규제를 철폐하는 노력을 지속해야한다"고 제언했다. 안 장관은 "정책 수립과 실행 과정에서 현장의 목소리를 적극 반영할 것"이라고 언급하고, "금년 상반기 중 「팹리스 경쟁력 강화방안」을 마련하겠다"고 밝혔다.

담당 부서	산업정책실 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	전성철 (044-203-4274)

대한민국 정책브리핑 OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 **텔레칩스 현장방문 개요**

□ (**일시**) 1.16.(火), 13:00~14:00

□ (**장소**) **텔레칩스**

【기업 개요(출처 : 기업 IR자료 및 공시자료)】

- (설립) '99.10월
- (분야) 차량용 반도체 설계(팹리스)
- (매출) '20년 1,007억원 → 1,364억원 → 1,504억원
- (직원) 327명
- (주소) 경기 성남시 수성구 금토로 80번기 27

□ (**참석**) 산업통상자원부 장관, 첨단산업정책관, 텔레칩스 대표 등

□ (**내용**) 간담회(기업 의견 청취), 현장시찰 등

시간		주요 내용	비고
13:00 ~ 13:03	(03')	• **인사말**	12층 간담회장
13:03 ~ 13:43	(40')	• 기업 소개 및 의견 청취	
13:43 ~ 13:55	(12')	• **현장 시찰**	12층 전시장
13:55 ~ 14:00	(05')	• 기념 촬영	1층 현관